

# ■電子デバイスフォーラム京都プログラム

(敬称略)

	10月30日(木)10:30-13:00	コース	10月30日(木)14:00-16:30	10月31日(金)10:30-13:00	10月31日(金)14:00-16:30
A	<b>K-1 挨拶・基調講演</b> ◆来賓挨拶 京都市長 門川 大作 ◆基調講演 「デバイス&システムプラットフォーム整備による国際競争力強化」 ㈱東芝セミコンダクター&ストレージ社 技監 柴田 英毅 ◆基調講演 「寸法微細化だけで進歩を遂げたシリコン超LSI技術の新しい進歩の方向」 東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチフェロー 大見 忠弘 ◆基調講演 「電子デバイスの爆発的成長の新時代が見えてきた!! ~M2M、医療、航空、自動車、鉄道で開花する成長アプリを最新レポート~」 半導体産業新聞特別編集委員 泉谷 渉	次世代自動車	<b>A-1 ICTとエレクトロニクスが変える次世代・近未来自動車</b> 山崎(シャープ)/中村(ローム) ◆自動運転の実用化に向けた取り組みと将来の展望 日産自動車(株) 総合研究所 研究企画部 主任研究員 平林 知己 ◆センサーネットワークとしてのコネクテッドカーが起こすクルマ社会のイノベーション インテル(株) 戦略企画室オートモティブユニット 兼 名古屋大学 客員准教授 野辺 継男 ◆サステイナブルモビリティへの対応と次世代パワー半導体への期待 トヨタ自動車(株) 第3電子開発部 主査 川井 文彰	<b>A-2 次世代自動車のための電子部品実装技術</b> 松浦(ルネサス)/中村(ローム) ◆車載用パワー半導体パッケージング技術の最新動向 ルネサス エレクトロニクス(株) 生産本部 実装技術開発統括部 パワーパッケージ開発部車載パワーパッケージ開発課 課長 小池 信也 ◆車載用パワー半導体モジュールの高放熱・高信頼性実装技術 富士電機(株) 技術開発本部 電子デバイス研究所 次世代モジュール開発センター パッケージ開発部 実装・設備Gr. マネージャー 西村 芳孝 ◆電気-熱-構造連成解析を用いたパワーモジュールの信頼性評価 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 干 強	<b>A-3 自動車の未来を支える次世代パワー半導体</b> 岡田(パナソニック)/山本(マイクロン)、上本(パナソニック) ◆車載用パワーデバイスの現状と今後の進化 ㈱デンソー デバイス事業部 半導体プロセス開発部 部長 深津 重光 ◆SiCパワーデバイス・モジュールの開発・実用化の現状 ローム(株) 研究開発本部 統括部長 中村 孝 ◆高温・高速動作を実現する次世代GaNデバイス関連技術 パナソニック(株) R&D本部 デバイスソリューションセンター パワーエレクトロニクスグループ 主幹技師 永井 秀一
	<b>B-1 ソーシャルデバイスがもたらす価値提供と産業変革</b> 岡田(日本IBM)/木村(ソニー) ◆M2Mとデータ駆動型経済 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 森川 博之 ◆IoT時代のスマート農業 ~科学とテクノロジーで実現する農業ルネッサンス~ ベジタリア(株)/㈱イラポ・エクスベリエンズ 代表取締役社長 小池 聡 ◆Trillion Sensors Universe時代の新たなヘルスケア ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチ 桜田 一洋		<b>B-2 センシングデバイスの最新動向と応用展開</b> 中谷(村田製作所)/木村(ソニー) ◆高速画像処理とその応用展開~CMOSイメージャの進歩が拓く新機能・新システム~ 東京大学 情報理工学系研究科 教授 石川 正俊 ◆積層一体型熱電素子の開発とセンサネットワーク電源への応用 ㈱村田製作所 先端技術研究開発センター 主任研究員 中村 孝則 ◆医療現場で活躍する光製品、光技術~光の可能性について~ 浜松ホトニクス(株) 営業本部 国内統括部 大阪営業所 所長 小栗 康則	<b>B-3 高速ネットワークが作り出す生体医療・スポーツへの応用・展開</b> 柴田(NTT)/雲梯(UNATE) ◆M2Mを支える低消費電力デバイス技術と高速ネットワーク技術~IEEE802.11標準化の最新動向とデバイス実装技術~ パナソニック(株) デバイスソリューションセンター 主幹技師 高橋 和晃 ◆フレキシブルエレクトロニクスの生体医療・ヘルスケア応用 大阪大学 産業科学研究所 教授 関谷 毅 ◆運動中の選手、児童および生徒からのリアルタイム生体情報センシング~ビジネスモデルと技術~ 大阪市立大学 大学院工学研究科 電子情報系専攻 教授 原 晋介	
C	<b>K-2 特別マーケット情報セミナー 10:30-12:00</b> ◆特別講演 「世界の半導体・電子部品のマーケット動向と日本のポジション ~トレンドとIoTが2020年以降のキーワード~」 IHSグローバル(株) IHS Technology / Japan Research Director 南川 明 ◆特別講演 「韓国半導体・液晶産業の将来性 ~サムスンの次の作戦は何か?~」 ㈱産業タイムス社ソウル支局長 嚴 在漢(オム・ジェハン)	次世代モバイル・ウェアラブル	<b>C-1 スマホからウェアラブルデバイスへ広がるアプリケーション</b> 柴田(NTT)/佐藤(京都大学) ◆スマートフォンの進化のあゆみと今後の展開 シャープ(株) 通信システム事業本部 要素技術開発センター 所長 安本 隆 ◆着だけでヘルスケアに役立つ:衣料X ICTによる生体情報センシングの取り組み 日本電信電話(株) マイクロシステムインテグレーション研究所 部長 佐藤 康博 ◆ウェアラブルデバイスの取り組みについて セイコーエプソン(株) HMD事業推進部 基幹社員 馬場 宏行	<b>C-2 モバイル・ウェアラブル機器電源の最新動向 ~エネルギーハーベスティング~</b> 戸所(奈良先端大)/藤原(東レ) ◆次世代モバイル・ウェアラブル向けエネルギーハーベスティング ㈱NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー 竹内 敬治 ◆海外におけるエネルギーハーベスティングデバイスとその応用 東京エレクトロンデバイス(株) グローバルビジネスデベロップメント部 新谷 浩造 ◆薄型軽量エレクトレット振動発電デバイスと応用例 オムロン(株) マイクロデバイス事業推進本部 技術開発部 技術専門職 積 知範	<b>C-3 次世代モバイル・ウェアラブル機器向け電子部品の最新動向</b> 中谷(村田製作所)、不破(ローム) ◆ロームの超小型電子部品戦略 ローム(株) ディスクリート・モジュール生産本部 RASPID開発課 課長 玉川 博詞 ◆世界最小0201サイズ チップ積層セラミックコンデンサの実用化 ㈱村田製作所 第1コンデンサ事業部 技術開発統括部 統括部長 大森 長門 ◆印刷技術を用いたフレキシブルデバイスの開発 (独)産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター 印刷エレクトロニクスデバイスチーム 研究チーム長 吉田 学
	<b>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジー・プラットフォームと産学連携</b> 戸所(奈良先端大) 第1部 講演 ◆微細加工プラットフォームの機能と役割 京都大学 理事・副学長 小寺 秀俊 ◆大阪大学の産学連携とナノテクノロジー・プラットフォーム 大阪大学 産業科学研究所 副所長・産学連携ナノテクノロジーセンター長 教授 吉田 陽一 第2部 ポスター展示と相談の受付 京都大学・大阪大学・奈良先端科学技術大学院大学のナノテクノロジー・プラットフォームおよび産学連携部門		<b>D-2 初心者のための半導体基礎講座①</b> 廣田(東京エレクトロン)/酒井(日新イオン機器/藤原(東レ)) ◆半導体のできるまで ~半導体デバイス・プロセスの基礎~ ウェストブレイン 代表 西久保 靖彦	<b>D-3 初心者のための半導体基礎講座②</b> ◆リソグラフィの基礎 大阪大学 産業科学研究所 特任教授 遠藤 正孝 ◆ドライエッチング入門 ~プラズマエッチングの基礎と装置・計測技術~ 東京エレクトロン宮城(株) 宮城技術開発センター NH技術開発Gr. グループリーダー 大矢 欣伸 ◆イオン注入・拡散・アニール拡散の基礎 ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング(株) ミックスドシングデバイス開発部 主幹技師 黒井 隆	
D		特別セッション			